



2025年9月17日

## 北洋銀行との半導体サプライチェーン構築に係る連携・協力に関する 覚書の締結について

当行は、北洋銀行(頭取 津山 博恒)と半導体サプライチェーン構築に係る連携・協力に関する覚書を締結しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

九州/熊本および北海道は“半導体政策における戦略の要”として位置付けられ、今後、半導体関連企業の集積および新たなサプライチェーン構築が進むと予測されています。一方で、地場中小企業の育成や新規参入の促進、生活インフラの整備、人材の育成・確保など、多岐にわたる課題への早急な対応が不可欠であり、その課題解決を支援することが地方銀行の役割だと考えています。今回の連携は、それぞれの地域経済の発展を進めるとともに、日本の半導体戦略を支えることを目的としたものです。

#### 2. 連携・協力内容

- (1) 各地域の企業進出動向などの情報共有
- (2) 産業集積に伴う誘致活動情報およびノウハウの共有
- (3) 地域課題の共有と課題解決に向けた取り組みの実施
- (4) 目的達成のため両当事者が必要と認める事項

【締結式の模様】(2025年9月17日 肥後銀行東京事務所にて)



以上